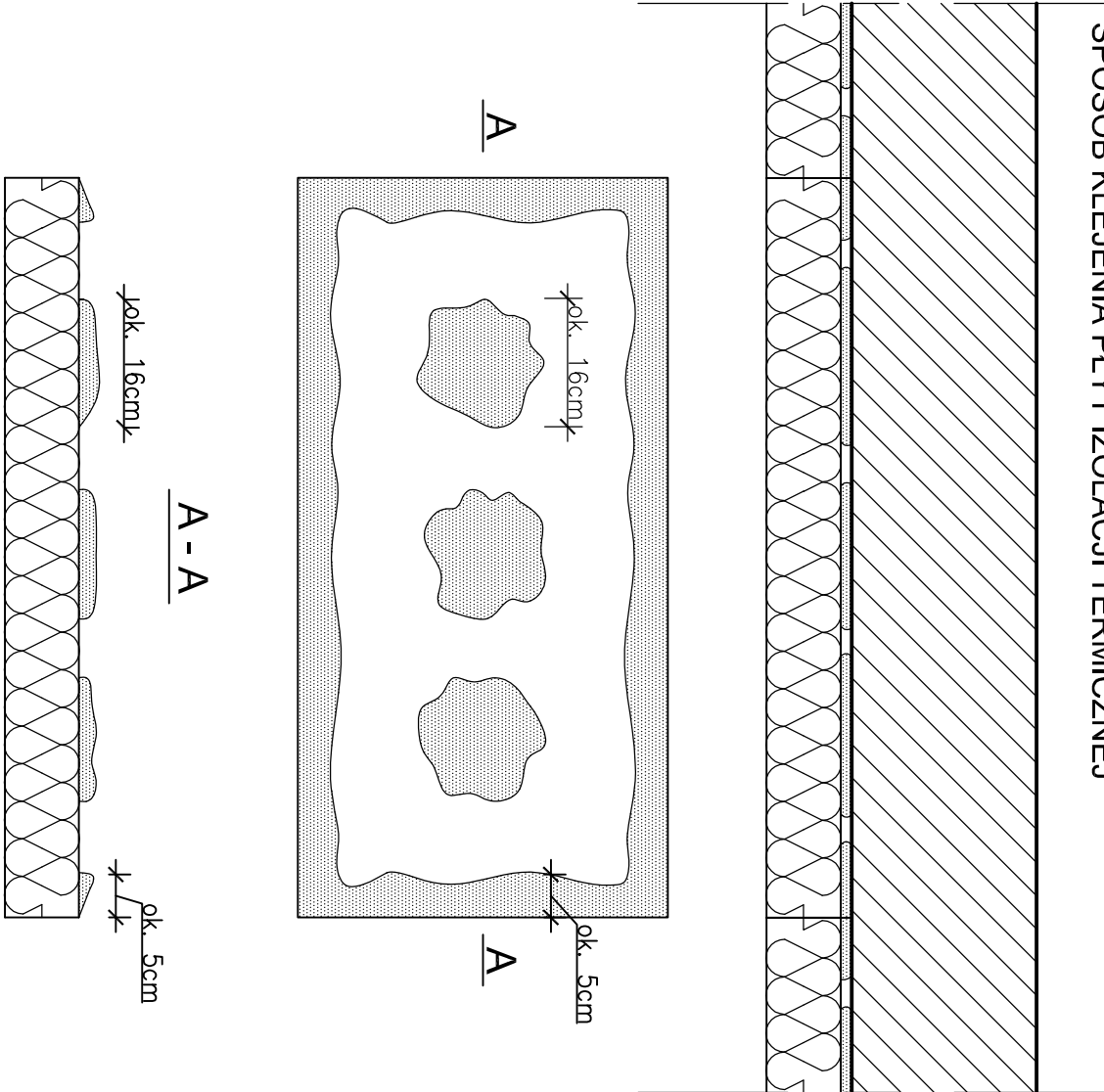


DETAL 1

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ




Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo–punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odczynki, równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża.

Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Płyty izolacji mocowane dodatkowo mechanicznie zg. z technologią producenta. Ilość kołków min.6szt/m2.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KEDZIERSKI			
e-mail: altyka@poczta.fm			
altkabiuro@poczta.fm			
www.altyka-architekci.com.pl			
www.passive-house.com.pl			
Częstochowa, ul. Elsniera 4h		tel. 531 773 803, 502 086 906	
nazwa inwestycji			
Termomodernizacja budynku Szkoły			
Podstawowej nr 36			
przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie			
adres inwestycji			
Częstochowa,			
dz. nr 82, 14/2 obręb 336			
inwestor			
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA			
UL. ŚLĄSKA 11/13			
42-217 CZĘSTOCHOWA			
faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kedziński	architektura	9/07/SŁ OKK	
inż. architekt	konstrukcja	96/02	
mgr inż. budownictwa			
tytuł rysunku			skala
DETAL 1: Sposób klejenia płyt izolacji termicznej			1:10
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			10
data opracowania		WRZESIEŃ 2017	